

테스 (095610)

도움닫기 끝, 적용처 3단 점프 시작

매수 (신규)

목표주가 (신규)	210,000원
현재가 (9/9)	154,300원

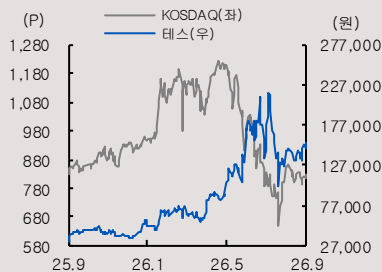
KOSDAQ (9/9)	830.37pt
시가총액	2,987십억원
발행주식수	19,360천주
액면가	500원
52주 최고가	217,500원
최저가	31,000원
60일 일평균거래대금	78십억원
외국인 지분율	10.5%
배당수익률 (2026F)	0.6%

주주구성	
주송일 외 8 인	29.46%
국민연금공단	9.96%

추가상승	1M	6M	12M
상대기준	19%	202%	394%
절대기준	24%	128%	398%

	현재	직전	변동
투자의견	매수	-	-
목표주가	210,000	-	-
EPS(26)	5,029	-	-
EPS(27)	5,817	-	-

테스 추가추이



본 조사분석자료는 당사 리서치부문에서 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 작성한 것이나 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으며, 과거의 자료를 기초로 한 투자참고 자료로서 향후 추가 움직임은 과거의 패턴과 다를 수 있습니다. 고객께서는 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자시기에 대해 최종 결정하시기 바라며, 본 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과에 대한 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다.

NAND 1,000단 돌파의 핵심 수혜주

테스는 반도체가 높아질수록 수요가 커지는 전공정 장비 제조사다. 300단 이상의 NAND 제조시 웨이퍼는 장시간 식각 공정에 노출된다. 동사의 ACL(Amorphous Carbon Layer)장비는 웨이퍼 표면의 패턴이 식각 공정에서 버틸 수 있도록 하드마스크라는 보조층을 증착한다. BSD(Backside Deposition) 장비는 웨이퍼 뒷면에 지지층을 형성해 힘을 방지하고, 수율을 개선한다. 반도체 업계가 1,000단 이상의 로드맵을 제시한 만큼 향후 고단화 트렌드에 따른 동사의 장비 수요도 지속 확대될 것으로 전망한다.

DRAM에서 HBM까지 종합 장비사로 체질 개선

디스카운트 요인이었던 1)DRAM향 매출 역성장 우려, 2)제한된 고객사, 3)부족한 장비 포트폴리오가 동시에 해소되는 시점이다. 2024년 처음 과반을 상회한 DRAM향 매출이 안정적으로 유지되고 있다. 주요 고객사의 신규 Fab 증설과 주력 장비인 ACL의 적용처가 DRAM까지 확대된 영향이다.

고객사 및 제품군 다변화도 시작했다. 신규 장비에 대한 테스트 종료 시점이 하반기에 도래하며, 제품 포트폴리오가 다변화될 것으로 전망한다. 특히, BSD 장비는 NAND를 넘어 HBM 및 DRAM까지 적용처를 확대할 것으로 예상한다. 신규 상장에 성공한 중화권 고객사도 증설을 이어갈 것으로 보여, 2026년 하반기 이후 국내에 집중된 매출의 지역적 다변화도 예상한다.

사상 최대 수주잔고가 가르키는 주가의 방향

2026년부터 폭발적 성장세를 기록한 수주잔고가 향후 주가 상승의 원동력이다. 지난 10년 중 동사의 최대 수주잔고는 869억 원에 불과했지만, 2Q26에는 2,069억 원을 기록하며 사상 최대치를 경신했다. 반도체 소부장 기업의 실적과 주가는 수주와 동행하는 경향성을 보이는데, 향후 신규 Fab 증설과 장비 인증 일정을 고려 시 수주잔고의 추가 확대를 전망한다.

(단위:십억원배)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	240	351	476	570	727
영업이익	38	58	96	128	181
세전이익	50	66	122	145	200
지배주주순이익	43	57	97	113	155
EPS(원)	2,158	2,885	5,029	5,817	8,025
증가율(%)	2,623.8	33.7	74.3	15.7	38.0
영업이익률(%)	15.8	16.5	20.2	22.5	24.9
순이익률(%)	17.9	16.2	20.4	19.8	21.3
ROE(%)	13.6	15.8	21.7	20.3	23.0
PER	7.2	15.4	29.4	25.5	18.5
PBR	0.9	2.2	5.7	4.7	3.9
EV/EBITDA	5.8	12.5	25.3	19.0	13.1

자료: Company data, IBK투자증권 예상

NAND 적층 트렌드와 함께 성장하는 기업

반도체가 높아지기
위해서는 보다 정밀한
증착, 세정 장비가 필요

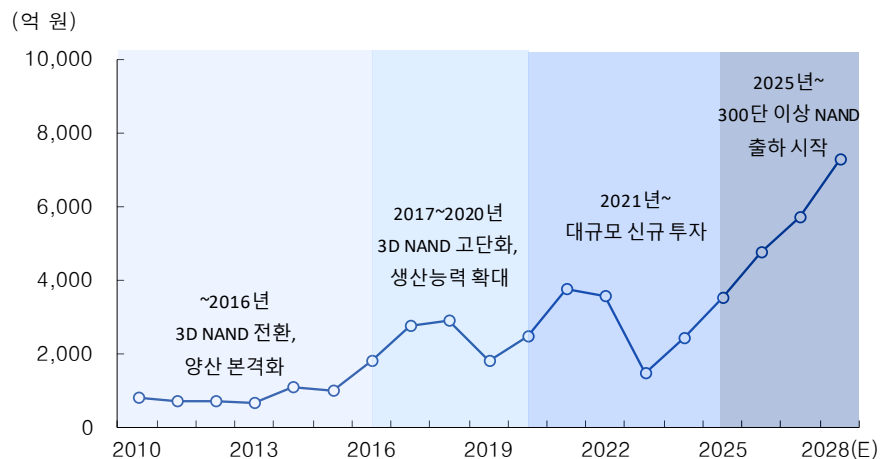
반도체가 고단화됨에 따라 테스의 증착·세정 장비에 대한 수요도 확대되고 있다. 셀을 높이 쌓을수록 공정횟수 및 시간이 증가하고, 오차 허용범위는 좁아져 고성능 장비에 대한 수요가 커지기 때문이다. 제조사들은 이미 셀을 수직으로 300단 이상 쌓은 NAND를 출시했고, 1,000단 이상의 적층 로드맵도 발표했다.

주요 고객사인
SK하이닉스는 이미
300단 NAND 시대 진입

동사 실적도 주요 고객사인 SK하이닉스가 3D NAND 양산을 시작했던 2016~2017년과 대규모 신규 투자를 집행한 2021년을 기점으로 크게 성장했다. 2025년에는 세계 최초로 321단 NAND 출하가 시작되었고, 2026년 전체 생산량 대비 10% 수준을 차지할 것으로 전망한다. 향후 300단 이상 고단 NAND 출하 확대를 위해 전환 및 신규 투자도 지속될 것으로 보인다.

그림 1. 테스 매출 추이 및 전망

NAND 기술 분기점에
발맞춰 매출 성장



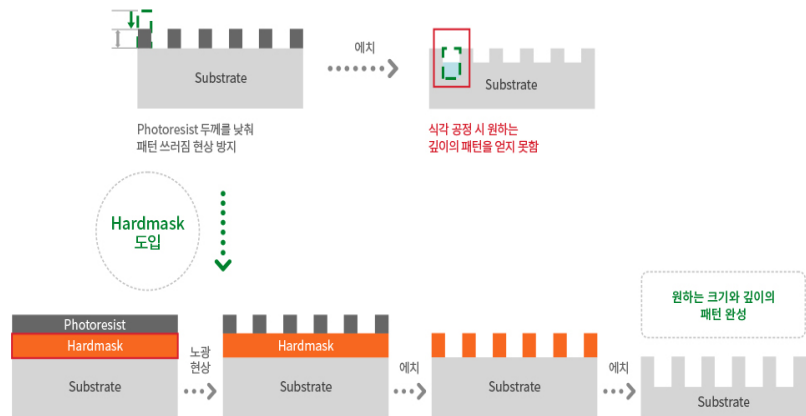
자료: 에프앤가이드 QuantiWise, IBK투자증권

ACL은 하드마스크 증착
BSD는 웨이퍼 후면 박막
증착

NAND 고단화와 직접적으로 맞물리는 장비는 ACL(Amorphous Carbon Layer)과 BSD(Backside Deposition)이다. ACL은 하드마스크 보조층을 증착해 긴 식각 공정에서 포토레지스트가 무너져 내리는 현상을 방지한다. BSD 장비는 웨이퍼 뒷면에 박막을 형성해 전면의 응력을 조절하고, 휨 현상을 방지한다. BSD는 NAND 공정에 주로 적용되었으나, 최근 HBM이 12단 이상으로 고단화됨에 따라 적용처를 확대할 것으로 예상된다.

그림 2. 반도체 식각 공정에서 Hard Mask의 역할

Hard Mask 보조층을
형성하는 ACL 장비



자료: SKecoplant, IBK투자증권

그림 3. 테스 전방 산업별 장비 포트폴리오

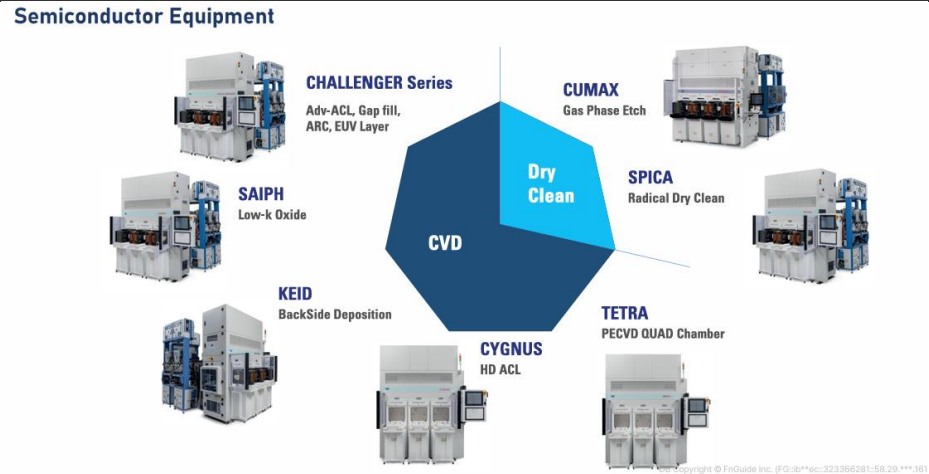
테스 장비의 주 적용처는
반도체/디스플레이 산업



자료: 테스, IBK투자증권

그림 4. 테스 반도체 공정용 장비 포트폴리오

반도체용 장비는 PECVD와
Dry Clean으로 구성



자료: 테스, IBK투자증권

디스카운트 요인이 해소되는 순간

NAND 및 특정 제품에
의존적 사업 구조 해소

테스의 밸류에이션 디스카운트 요소들이 동시에 해소되는 시점이다. 할인 요인은 ① DRAM향 매출 역성장 우려, ② 제한적인 고객 기반, ③ 부족한 장비 포트폴리오 등이었다. 2024년 이전까지 실적은 국내 메모리사의 NAND 투자 및 특정 제품에 의존적인 구조였다. 제품 역시 ALD(Atomic Layer Deposition, 원자층 증착) 등 선단 증착 장비를 보유한 타 전공정 기업과 비교해 성장 영역에 대한 노출도가 낮다는 평가를 받았다.

DRAM 향 매출 비중은
장기적으로 과반 유지할 것

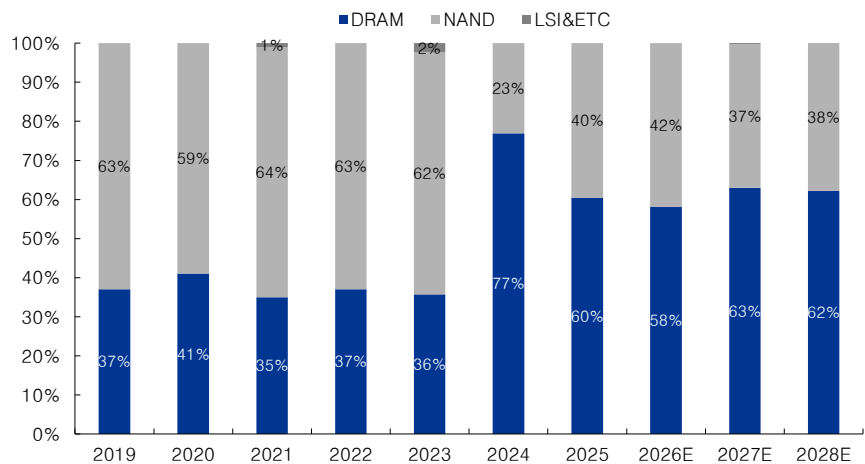
2024년을 기점으로 과반을 상회한 DRAM향 매출은 향후 안정적 수준을 유지할 것으로 전망한다. 2025년 하반기부터 시작된 SK하이닉스 M15X와 삼성전자 P4향 신규 투자가 DRAM향 매출 성장을 견인했다. DRAM 향 수요의 중장기적 가시성도 높다. 2027년 이후 삼성전자 P5(평택 5공장), SK하이닉스 Y1(용인 1공장)까지 신규 및 전환 투자 일정이 이어질 것으로 전망하기 때문이다.

NAND에서 DRAM 및
HBM으로 적용처 확대

DRAM 미세화와 HBM 적층수 증가가 장기 수요를 견인하는 요소다. 선단 DRAM은 선폭이 줄어들수록 Capacitor를 더 높고 깊게 형성하기 위해 식각 난도가 상승하며, 이에 따라 식각 과정에서 패틴을 보호하는 ACL의 적용이 확대된다. HD-ACL은 ACL보다 높은 선폭비의 하드마스크를 증착하는 신규 장비로 1d 이상의 선단 공정 중심으로 도입을 전망한다.

24년 DRAM 매출 과반 달성
↓
25년 NAND 전환 투자 재개,
DRAM, NAND 모두 성장
↓
향후 DRAM향 매출 비중은
지속적으로 과반 상회 전망

그림 5. 테스 DRAM/NAND 매출 비중 추이



자료: 테스, IBK투자증권

2026년 하반기,
신규 장비 인증 시점 도래

장비 포트폴리오 확대와 고객사 다변화 역시 중요한 변화다. 신규 장비별 인증 및 공급이 금년 하반기부터 내년 상반기까지 이어질 것으로 보인다. 2025년 신규 장비의 매출 비중은 약 10% 수준이었으나, 2026년에는 10% 중반까지 확대될 것으로 전망한다. 테스트 일정을 고려 시 본격적인 신규 장비 매출 성장의 기점은 2027년이 될 것으로 전망한다.

BSD는 HBM 및 파운드리
적용 기대

BSD 장비는 금년 상반기 SK하이닉스 DRAM 및 HBM향 인증을 완료했고, SiCN(Silicon Carbon Nitride, 절연막) 박막 증착용 장비인 TETRA도 삼성전자 DRAM향 인증을 완료했다. BSD 장비는 삼성전자 파운드리 HBM 4nm Base Die향으로도 적용처를 넓힐 것으로 전망한다. HD-ACL(High Density ACL)은 DRAM 1d향 적용이 기대되며, 예상하는 인증 시점은 2026년 하반기~내년 상반기이다. Low-K(절연막 형성 장비) 역시 DRAM 배선층용 저유전막 증착 장비로 공급되고 있다.

중국향 매출 재개로
지역 다변화도 현실화

고객사 다변화도 본격화되고 있다. 기존 매출 구조는 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 메모리 업체에 집중된 형태지만, 최근 중국 DRAM 고객사의 투자 재개로 금년 해외 매출이 증가할 것으로 전망한다. 중국 고객사향 매출은 2026년 전사 매출 대비 10%까지 성장할 것으로 전망한다. 미국과 일본 메모리사를 대상으로 Demo 테스트도 진행 중이다.

표 1. 테스트 장비별 역할

신규 장비 중심
적용처, 고객사 확대

구분	장비명	공정/적용	고객사	설명
PECVD 장비	ACL	Hard Mask 증착	삼성전자, SK하이닉스, 중화권	Hard Mask 박막 증착
	ARC	Anti-Reflection Coating	SK하이닉스	노광 공정에서 빛 반사를 억제하기 위한 박막 증착
	BSD	Backside Stress / SiO ₂ , SiN 막	삼성전자, SK하이닉스	웨이퍼 휨을 저감하는 스트레스 제어막 증착
	Low-K	절연막 형성	SK하이닉스	DRAM용 Low-k 절연막 증착 장비
건식 세정 장비	GPE (Gas Phase Etcher)	건식 세정	삼성전자, SK하이닉스	건식 가스 방식, 고선택비로 고밀도 공정에 적용

자료: IBK투자증권

투자 의견 매수, 목표주가 210,000원 신규 제시

주요 전공정 장비사
수준의 밸류에이션
재평가가 필요한 시점

테스에 대한 투자 의견 매수, 목표주가 210,000원을 신규 제시한다. 현 주가는 당사 추정 12개월 선행 EPS 기준 27.8x 수준으로 역사적 고점 부근이나, 달라진 펀더멘털을 고려해 재평가가 필요한 시점이다. 목표주가는 당사 추정 12개월 선행 EPS 5,555원과 Target Multiple 37.0x를 적용해 산출했다. Target Multiple은 국내 반도체 전공정 장비 대표 기업인 원익IPS, 피에스케이, 브이엠, 유진테크의 2026F P/E 평균 값을 30% 할인해 적용했다. PECVD 기술에 제품 포트폴리오가 집중되어 있다는 점이 할인율을 반영한 이유다.

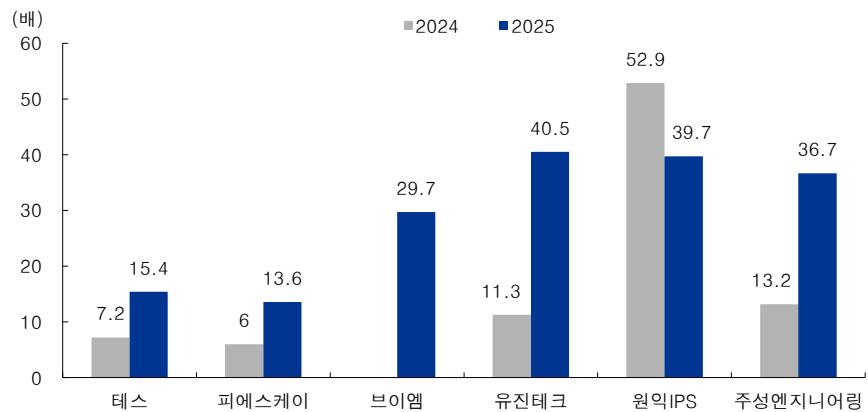
표 2. 테스 Valuation Table

구분	값	설명
EPS (원)	5,555	당사 추정 12MF 주당순이익
PER (배)	52.8	국내 전공정 장비기업 26F P/E 평균
할인율	30.0%	PECVD 기술에 집중된 제품 포트폴리오 고려
Target Multiple (배)	37.0	
값 (원)	205,535	
목표주가 (원)	210,000	Rounding
현재주가 (원)	154,300	2026.09.09 주가
과리율	36%	

자료: IBK투자증권

주: 주성엔지니어링, 원익IPS, 브이엠, 피에스케이, 유진테크의 2026F 평균 P/E 값을 적용

그림 6. 주요 반도체 전공정 장비사 P/E Multiple 추이



자료: IBK투자증권

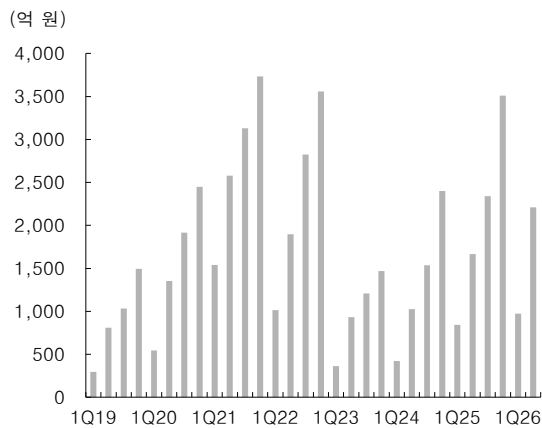
신규 장비 레퍼런스
확대가 향후 주가 상승의
모멘텀

그러나 밸류에이션 상단을 가로막아왔던 요소들이 해소되는 시점이라는 점을 고려해
주가 상승 가능성을 높게 평가한다. 특히, BSD, Low-L, HD-ACL 등 선단 공정을
대상으로 장비 레퍼런스가 확대되고 있다는 점이 향후 주가 상승의 모멘텀이다.

2Q26 수주잔고는 이전
최대치를 1,200억 원 상회

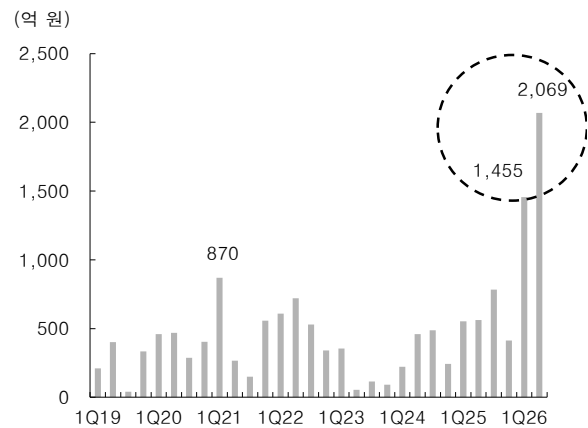
수주잔고가 역대 최대치를 경신한 점도 긍정적 요소다. 반도체 소부장 기업의 주가는
수주와 동행하는 경향성을 보이는데, 동사는 수주부터 매출인식까지 기간이 짧아
상관관계가 더욱 강할 것으로 전망한다. 지난 10년간 동사의 분기 최대 수주잔고는
1Q21 869억 원에 불과했지만, 2Q26 기준 수주잔고는 2,069억 원을 기록해 사상
최대치를 경신했다.

그림 7. 테스 분기별 납품액 추이



자료: 테스, IBK투자증권

그림 8. 테스 분기별 수주잔고 추이



자료: 테스, IBK투자증권

표 3. 주요 전공정 장비 업체 연도별 P/E Multiple 추이

(단위: 배)

예상 실적 기준									
종목명	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
테스	5.3	40.6	21.5	9.6	7.1	81.1	11.4	14.5	25.8
피에스케이	-	-	20.7	9.6	5.1	14.8	6.3	13.5	23.5
브이엠	5.2	-	21.6	-	-	-	-	41.1	19.0
유진테크	7.2	23.3	91	19.2	10.5	34.3	15.3	37.8	21.6
원익PS	8.2	34	16.5	13.3	11.1	324.6	60.2	44.2	25.0
주성엔지니어링	7.8	10.6	-	13.2	4.7	52.2	12.4	25.7	181.5
확정 실적 기준									
종목명	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
테스	5.7	50.7	19.5	8.0	6.6	253.7	7.2	15.4	-
피에스케이	-	17.5	26.9	10.2	5.8	11.6	6.0	13.6	-
브이엠	7.2	12.4	19.8	11.3	9.1	-	-	29.7	-
유진테크	12.8	65.6	219.3	19.6	13.4	38.3	11.3	40.5	-
원익PS	9.6	40.5	22.2	14.3	13.6	-	52.9	39.7	-
주성엔지니어링	7.3	14.4	-	7.0	4.8	48.5	13.2	36.7	-

자료: IBK투자증권

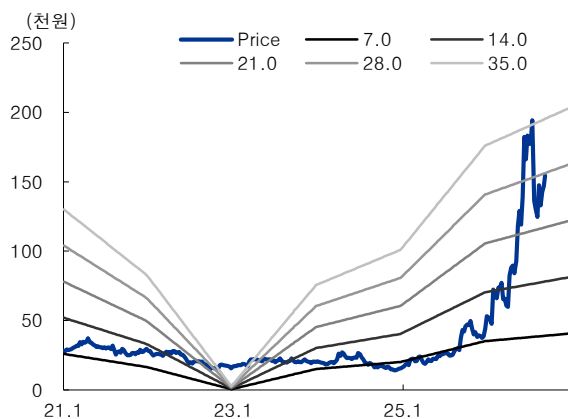
주: 피에스케이 2019년 인적분할 후 상장

표 4. 테스 실적 추정치

(단위: 억 원)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26(E)	4Q26(E)	2025	2026(E)	2027(E)
매출액	845	821	676	1,170	972	1,237	1,169	1,378	3,511	4,755	5,703
PECVD+DRY CLN	634	648	419	737	654	989	935	1,061	2,438	3,639	3,977
PARTS	211	172	257	363	314	235	234	289	1,003	1,072	1,633
OLED	-	-	-	70	4	12	-	28	70	44	93
QoQ (%)											
PECVD+DRY CLN	9%	2%	-35%	76%	-11%	51%	-6%	13%	-	-	-
PARTS	-19%	-18%	49%	41%	-13%	-25%	-1%	24%	-	-	-
OLED	-100%	-	-	-	-94%	218%	-100%	-	-	-	-
YoY (%)											
PECVD+DRY CLN	155%	76%	23%	27%	3%	53%	123%	44%	58%	49%	9%
PARTS	25%	-25%	53%	40%	49%	36%	-9%	-20%	21%	7%	52%
OLED	-100%	-	-	170%	-	-	-	-61%	132%	-38%	112%
매출원가	617	549	521	904	676	871	774	948	2,590	3,269	3,909
매출총이익	228	272	155	265	297	365	394	430	921	1,486	1,794
QoQ	-25.3%	19.1%	-43.0%	71.1%	11.8%	23.0%	8.0%	8.9%			
YoY	192.9%	71.4%	50.4%	-13.2%	30.0%	34.3%	154.1%	61.8%	42.6%	61.3%	20.7%
판매비	66	68	71	138	75	105	111	123	343	414	483
영업이익	163	204	84	128	222	260	283	307	578	1,072	1,311
QoQ	-26.1%	25.2%	-58.7%	51.9%	73.7%	17.2%	8.8%	8.3%			
YoY	582.5%	103.5%	107.1%	-41.9%	36.5%	27.8%	236.3%	139.8%	50.3%	85.3%	22.3%

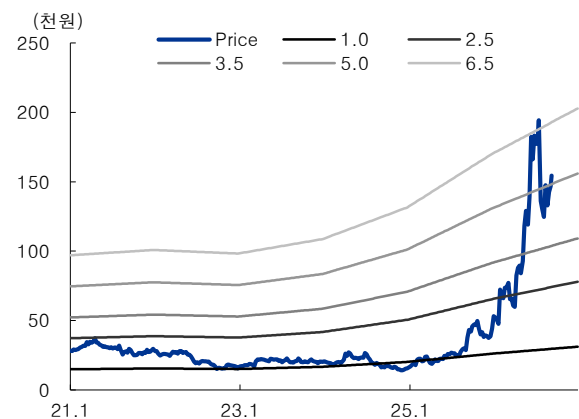
자료: IBK투자증권

그림 9. 테스 12MF PER Band



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, IBK투자증권

그림 10. 테스 12MF PBR Band



자료: 에프앤가이드 QuantiWise, IBK투자증권

테스 (095610)

포괄손익계산서

(십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
매출액	240	351	476	570	727
증가율(%)	63.4	46.3	35.4	19.9	27.4
매출원가	176	259	338	394	478
매출총이익	65	92	138	177	249
매출총이익률 (%)	27.1	26.2	29.0	31.1	34.3
판매비	26	34	41	48	68
판매비율(%)	10.8	9.7	8.6	8.4	9.4
영업이익	38	58	96	128	181
증가율(%)	-756.3	50.3	66.7	33.1	40.9
영업이익률(%)	15.8	16.5	20.2	22.5	24.9
순금융손익	13	10	22	16	19
이자손익	4	3	3	6	9
기타	9	7	19	10	10
기타영업외손익	-1	-2	4	0	0
종속/관계기업손익	0	0	0	0	0
세전이익	50	66	122	145	200
법인세	7	9	25	32	45
법인세율	14.0	13.6	20.5	22.1	22.5
계속사업이익	43	57	97	113	155
중단사업손익	0	0	0	0	0
당기순이익	43	57	97	113	155
증가율(%)	2,623.8	33.4	71.1	15.7	38.0
당기순이익률 (%)	17.9	16.2	20.4	19.8	21.3
지배주주당기순이익	43	57	97	113	155
기타포괄이익	-2	3	2	0	0
총포괄이익	40	60	99	113	155
EBITDA	44	66	107	138	189
증가율(%)	na	48.5	62.6	28.8	37.6
EBITDA마진율(%)	18.3	18.8	22.5	24.2	26.0

투자지표

(12월 결산)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
주당지표(원)					
EPS	2,158	2,885	5,029	5,817	8,025
BPS	16,721	20,235	26,157	31,195	38,460
DPS	600	850	850	850	850
밸류에이션(배)					
PER	7.2	15.4	29.4	25.5	18.5
PBR	0.9	2.2	5.7	4.7	3.9
EV/EBITDA	5.8	12.5	25.3	19.0	13.1
성장성지표(%)					
매출증가율	63.4	46.3	35.4	19.9	27.4
EPS증가율	2,623.8	33.7	74.3	15.7	38.0
수익성지표(%)					
배당수익률	3.9	1.9	0.6	0.6	0.6
ROE	13.6	15.8	21.7	20.3	23.0
ROA	12.1	13.1	17.7	16.6	18.8
ROIC	30.2	32.1	54.2	63.0	85.3
안정성지표(%)					
부채비율(%)	15.3	24.4	21.2	22.5	22.3
순차입금 비율(%)	-14.5	-15.6	-33.4	-43.0	-52.8
이자보상배율(배)	490.4	91.2	82.0	193.0	254.9
활동성지표(배)					
매출채권회전율	11.6	11.5	16.3	15.3	15.2
재고자산회전율	5.1	8.4	8.8	7.6	7.5
총자산회전율	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9

*주당지표 및 밸류에이션은 지배주주순익 및 지배주주지분 기준

재무상태표

(십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
유동자산	183	215	345	477	652
현금및현금성자산	12	12	97	160	263
유가증권	52	106	97	128	160
매출채권	35	26	32	42	53
재고자산	41	43	65	86	108
비유동자산	198	272	268	263	259
유형자산	110	136	135	126	118
무형자산	5	5	6	5	5
투자자산	71	117	115	115	115
자산총계	381	487	614	740	911
유동부채	37	48	91	119	148
매입채무및기타채무	13	1	33	44	55
단기차입금	6	6	7	9	11
유동성장기부채	0	5	5	5	5
비유동부채	13	48	16	17	18
사채	0	41	11	11	11
장기차입금	10	5	3	3	3
부채총계	51	96	107	136	166
지배주주지분	331	392	506	604	745
자본금	10	10	10	10	10
자본잉여금	57	64	78	78	78
자본조정등	-57	-42	-25	-25	-25
기타포괄이익누계액	0	3	-2	-2	-2
이익잉여금	320	356	445	543	683
비지배주주지분	0	0	0	0	0
자본총계	331	392	506	604	745
비이자부채	35	39	82	109	136
총차입금	16	57	25	27	30
순차입금	-48	-61	-169	-260	-393

현금흐름표

(십억원)	2024	2025	2026F	2027F	2028F
영업활동 현금흐름	31	82	97	91	132
당기순이익	43	57	97	113	155
비현금성 비용 및 수익	6	23	-3	-7	-11
유형자산감가상각비	5	7	10	9	8
무형자산상각비	1	0	0	0	0
운전자본변동	-25	-4	-6	-20	-21
매출채권등의 감소	-33	11	-12	-10	-11
재고자산의 감소	13	-5	-21	-21	-22
매입채무등의 증가	1	-16	31	11	11
기타 영업현금흐름	7	6	9	5	9
투자활동 현금흐름	-50	-118	-2	-41	-44
유형자산의 증가(CAPEX)	-55	-33	-6	0	0
유형자산의 감소	0	0	0	0	0
무형자산의 감소(증가)	0	0	0	0	0
투자자산의 감소(증가)	-37	-50	-1	0	0
기타	42	-35	5	-41	-44
재무활동 현금흐름	10	36	-11	13	14
차입금의 증가(감소)	10	0	0	0	0
자본의 증가	0	0	0	0	0
기타	0	36	-11	13	14
기타 및 조정	0	0	1	0	1
현금의 증가	-9	0	85	63	103
기초현금	21	12	12	97	160
기말현금	12	12	97	160	263

Compliance Notice

동 자료에 게재된 내용들은 외부의 압력이나 부당한 간섭없이 본인의 의견을 정확하게 반영하여 작성되었음을 확인합니다.

동 자료는 기관투자자 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.

동 자료는 조사분석자료 작성에 참여한 외부인(계열회사 및 그 임직원등)이 없습니다.

조사분석 담당자 및 배우자는 해당종목과 재산적 이해관계가 없습니다.

동 자료에 언급된 종목의 지분을 1%이상 보유하고 있지 않습니다.

당사는 상기 명시한 사항 외 고지해야 하는 특별한 이해관계가 없습니다.

종목명	담당자	담당자(배우자) 보유여부			1%이상 보유여부	유가증권 발행관련	계열사 관계여부	공개매수 사무취급	IPO	회사채 지급보증	중대한 이해관계	M&A 관련
		수량	취득가	취득일								

해당 사항 없음

투자 의견 안내 (투자기간 12개월)

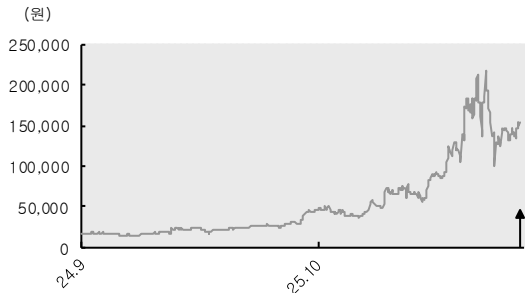
종목 투자 의견 (절대수익률 기준)			
매수 15% 이상	Trading Buy (중립) 0%~15%	중립 -15%~0%	축소 -15% 이상 하락
업종 투자 의견 (상대수익률 기준)			
비중확대 +10% ~	중립 -10% ~ +10%	비중축소 ~ -10%	

투자등급 통계 (2025.07.01~2026.06.30)

투자등급 구분	건수	비율(%)
매수	143	95.3
Trading Buy (중립)	6	4
중립	1	0.7
매도	0	0

최근 2년간 주가 그래프 및 목표주가(대상 시점 1년) 변동 추이

(▲) 매수, (■) Trading Buy (중립), (●) 중립, (◆) 축소, (■) Not Rated / 담당자 변경

테스	추천일자	투자 의견	목표가(원)	과리율(%)	
				평균	최고/최저
	2026.09.09	매수	210,000		